



Taiwan Semiconductor Industry Association



>> 專題報導

- 準備迎接 IFRS 18 – 財務績效表達之重大變革
- 2025 TSIA 年會暨半導體獎頒獎典禮活動報導

>> 國際瞭望

- 我國參加第 26 屆政府間半導體會議 (GAMS) 情形
- 2025 GAMS / JSTC 會議報告
- 2025 GAMS 環安小組會議記要
- 參加 SIA Awards Dinner 心得分享

2026

January

NO. 115

目錄 contents



創刊日期：中華民國 86 年 7 月
出版字號：新聞局版台省誌字 1086 號
發行人：侯永清
總編輯：吳志毅
執行編輯：陳淑芬 / 江珮君
編輯小組：石英堂 / 黃佳淑 / 陳昱錡 / 顏嘉霏
發行所：台灣半導體產業協會
地址：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號
53 館 802 室
網址：www.tsia.org.tw
電話：03-591-3181
傳真：03-582-0056
E-mail：candy@tsia.org.tw
美術編輯：創意有方設計有限公司
地址：新竹縣竹北市福興路 875 號 3 樓
電話：03-6563925 / 6563950
傳真：03-6571809

台灣半導體產業協會簡訊

TSIA NEWSLETTER 2026 | January NO. 115

編者的話

值此新春佳節，TSIA 衷心感謝全體會員過去一年的支持與協助，使各項會務圓滿推動。新的一年，TSIA 祝福大家：新年快樂、闔家平安！祈願各位事業順利、生意興隆，如駿馬奔騰般萬事亨通，馬年行大運！

本期「專題報導」單元的兩篇專文，一篇是安侯建業聯合會計師事務所與會員分享的「準備迎接 IFRS 18 - 財務績效表達之重大變革」，解析 IFRS 18 改版重點、實務關注之熱門議題、對企業的挑戰，及對於會員的建議。另一篇為 2025 年 10 月 23 日舉辦的 TSIA 年會暨半導體獎頒獎典禮活動報導。此次年會吸引將近 450 位會員及非會員參加，與會來賓互動熱絡，當日的專題演講及論壇也獲得熱烈迴響，藉由此篇專文，記錄當日之盛況，並感謝大家的熱情參與。

2025 年 11 月 WSC 的 JSTC 及 ESH 等相關工作小組會議，以及年度的政府間半導體會議 (GAMS)，於韓國釜山舉行，相關會議報導請參閱「國際瞭望」單元，會員得以從中了解最新的國際間半導體產業關切的議題及相關發展，尤其環安、半導體供應鏈、關稅、政府支持措施、人力短缺等，會員公司若對相關議題的討論有興趣或疑問，也歡迎與 TSIA 秘書處聯絡。

本期「會務報導」相關活動包括市場趨勢研討會、財務研討會、及校園巡迴演講系列、委員會活動摘要、以及新會員介紹等，感謝會員公司對 TSIA 各項活動的支持及參與，也歡迎會員公司就 TSIA 活動提出建議。

新的一年開始，TSIA 已密集籌畫來年的各項活動，敬請期待，也歡迎會員與非會員公司踴躍報名參加。活動詳情與報名辦法請密切注意 TSIA 網站 www.tsia.org.tw 發佈之訊息。

約稿

1. 本簡訊歡迎您的投稿，文章主題範疇包含國內外半導體相關產業技術、經營、市場趨勢等。內文 (不包含圖表) 以不超過四千字為原則，本會保有刊登之權利。
2. 來稿歡迎以中文打字電腦檔投稿，請註明您的真實姓名、通訊處、聯絡電話及服務單位或公司，稿件一經採用，稿費從優。
3. 本簡訊歡迎廠商刊登廣告，全彩每頁三萬元，半頁一萬八千元。會員廠商五折優待。意者請洽：江珮君 03-591-3181 或 email 至：candy@tsia.org.tw

01 編者的話

專題報導

- 02 準備迎接 IFRS 18 - 財務績效表達之重大變革
- 08 2025 TSIA 年會暨半導體獎頒獎典禮活動報導

國際瞭望

- 14 我國參加第 26 屆政府間半導體會議 (GAMS) 情形
- 16 2025 GAMS / JSTC 會議報告
- 22 2025 GAMS 環安小組會議紀要
- 24 參加 SIA Awards Dinner 心得分享

會務報導

- 26 TSIA 2025Q3 IC 產業動態觀察與展望暨研討會
- 30 TSIA 財務委員會研討會系列報導
- 32 2025 TSIA 校園巡迴講座系列
- 34 TSIA 委員會活動摘要
- 36 新會員介紹

遊憩人間

- 38 2025 x Summer x Singapore

廣告索引

- 29 2026 IC 設計聯誼會贊助方案
- 33 2026 TSIA 產學基金募集
- 37 TSIA 入會申請資格及辦法
- 42 2026 TSIA 半導體獎募款
- 43 WSTS 半導體統計資料訂購辦法

準備迎接 IFRS 18- 財務績效表達之重大變革

■ 安侯建業聯合會計師事務所 / 呂倩慧 執業會計師 / 王美齡 執業會計師 / 胡馨文 協理

一、導言

在快速變遷的商業環境中，企業不僅要衝業績以拓展業務成長，更要時時關注會計領域發展的最新動態。為促使公司於財務報表中進行具連結性之描述，且能清楚告知投資人、債權人及其他利害關係人有關企業故事的來龍去脈，國際會計準則理事會（以下稱 IASB）對國際會計準則第 1 號（以下稱 IAS 1）進行大改版，誕生了全新面貌的國際財務報導準則第 18 號「財務報表中之表達與揭露」（以下稱 IFRS 18），以滿足各方對財報表達提供更多資訊與可比性之期待，損益表重新整容後，儘管公司之淨利保持不變，但企業所關切之營業損益組成項目，會因新規定及新判斷而重新分隊。

金管會鑒於減輕企業接軌壓力、確保投資人能了解新規定及同步配合修訂相關法規，114 年 9 月 25 日新聞稿宣布台灣延後一年適用 IFRS 18，預計於 117 會計年度（2028 年）才正式登場，讓企業有更充裕的時間做出最佳準備。

二、重大變革重點解析

透過以下關鍵面向之介紹，期望有助於讀者理解 IFRS 18 的輪廓：

• 更具結構化之損益表

我們不妨想像一下，同一位消費者去不同超市買「大杯草莓牛奶」，結果發現每家店對「大杯」及「牛奶」的定義都不一樣，有的 500ml，有的 650ml，有的加果糖，有的加牛奶，甚至有的店家是加煉乳，雖然名字都叫「大杯草莓牛奶」，但實際內容卻有所差異，這正是現行 IAS 1 下損益表「營業利益」的現況。IAS1 對於四大表的結構僅有原則性規範，尤其損益表各項小計（如營業利益）等並無明確定義，也可能出現同樣稱為「營業利益」計算內容卻可能截然不同。國際間各公司可自由選擇報表格式列報財務結果，這使得跨國投資人在進行財務分析時失去可比性，難以準確比較各公司間的財務績效。

在台灣，由於公開發行公司財務報表受到「證券發行人財務報告編製準則」（以下稱編準）規範，財報格式比較一致，因此，財報使用者並未明顯感受到不同公司間財報缺乏比較性的問題。但在國際，投資人為了經濟決策目的需要更為透明、一致及可比的財務績效資訊，因此，IASB 制定 IFRS 18 以回應來自利害關係人（特別是來自財務報表使用者）對改善財務績效報導之強烈需求。

• 三個新種類

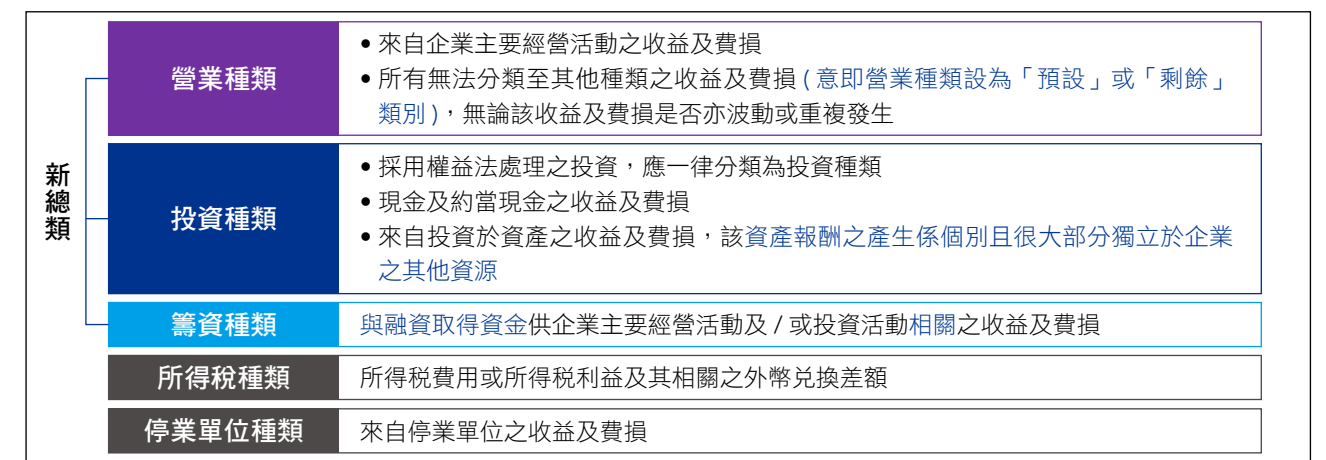
IFRS 18 規定，根據公司之主要經營活動，將收益及費損分為五種類，其中新增三個新種類為：營業種類、投資種類及籌資種類，且維持兩個既有之所得稅種類及停業單位種類，請詳圖一概要說明。IFRS 18 分類損益的邏輯，不是直接看損益項目的名稱，而是要去看這筆損益源自哪個資產或負債，從資產或負債的性質來判斷損益應歸屬哪個種類。

新準則規定資產報酬之產生係個別且很大部分獨立於個體之其他資源者，該資產產生之收益及費損係分類至投資種類（本文亦簡稱為非營業資產）；不符合此定義的資產（本文亦簡稱為營業資產）所產生之收益及費損則屬於營業種類。舉例來說，出租的投資性不動產可個別且很大部分係獨立於公司之其他資源產生報酬，因此租金收入及該資產之折舊、減損與處分損益等是分類至「投資種類」；反之，不動產、廠房及設備需要結合公司的其他資源才能產生報酬，於損益表處分該資產之損益依 IFRS 18 係分類為「營業種類」（請詳圖二）。

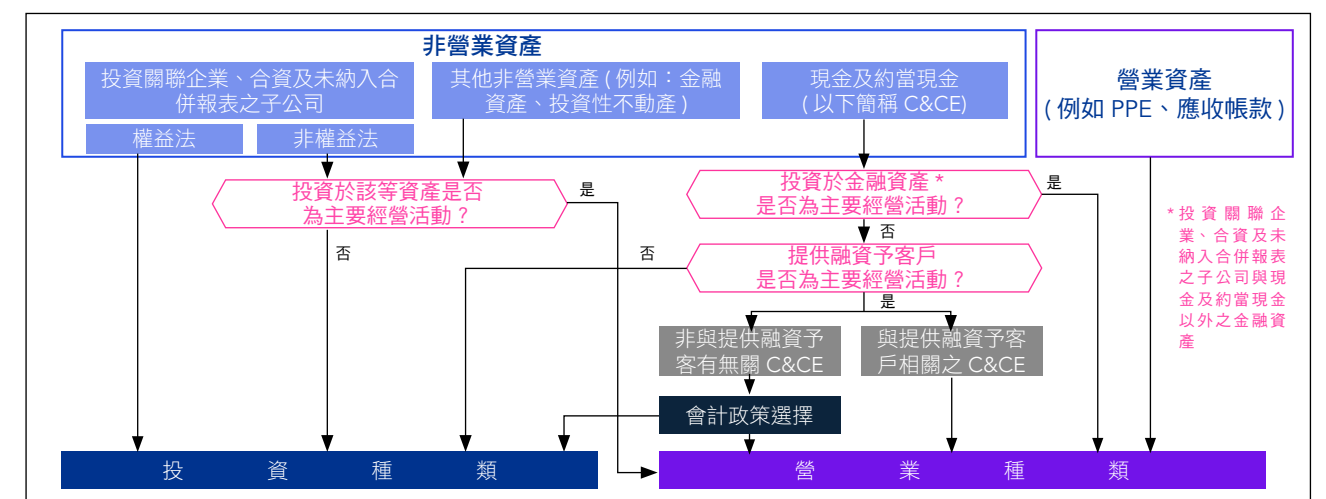
如果是借款或發行債券等僅涉及取得融資之交易所產生之收益及費損是分類至籌資種類；其他類型的負債所產生之收益及費損，除了利息要素分類至籌資種類外，其餘收益及費損是分類至營業種類（請詳圖三）。

需注意，若企業具有「特定主要經營活動」，除遵循一般規定外，尚應加碼遵循額外之特殊規定。更詳細內容，請繼續往下閱讀。

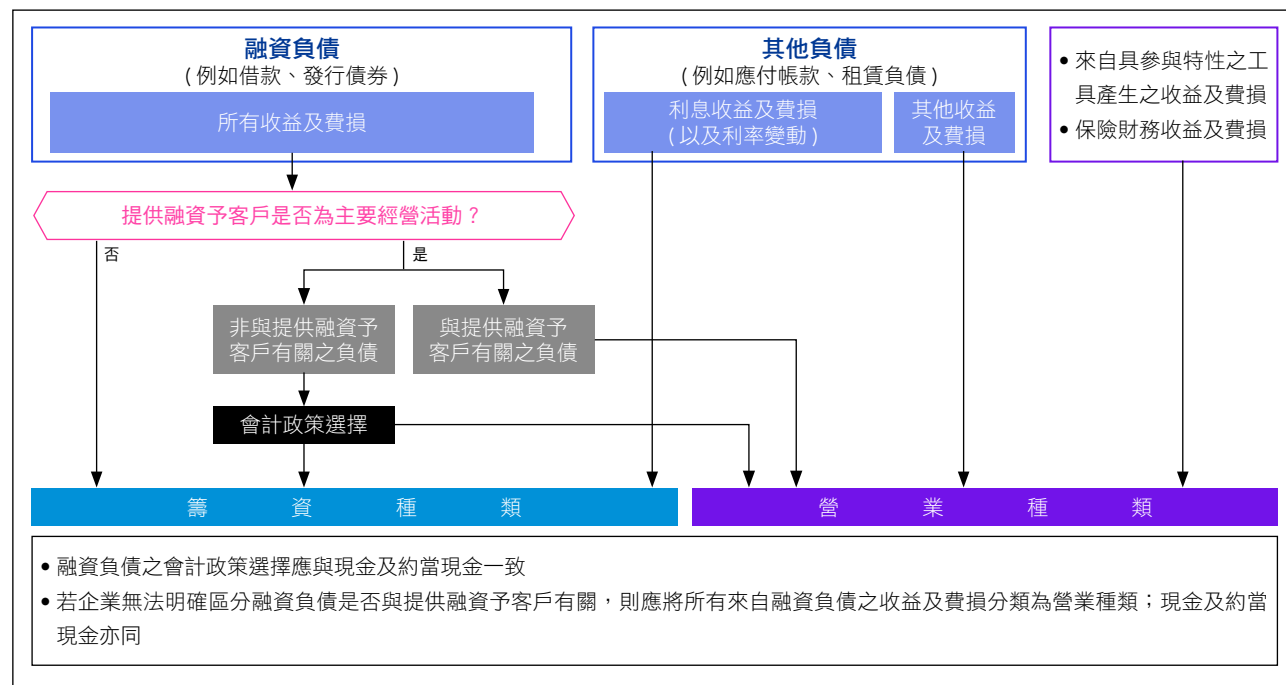
圖一、收益及費損分類



圖二、來自資產之收益及費損分類



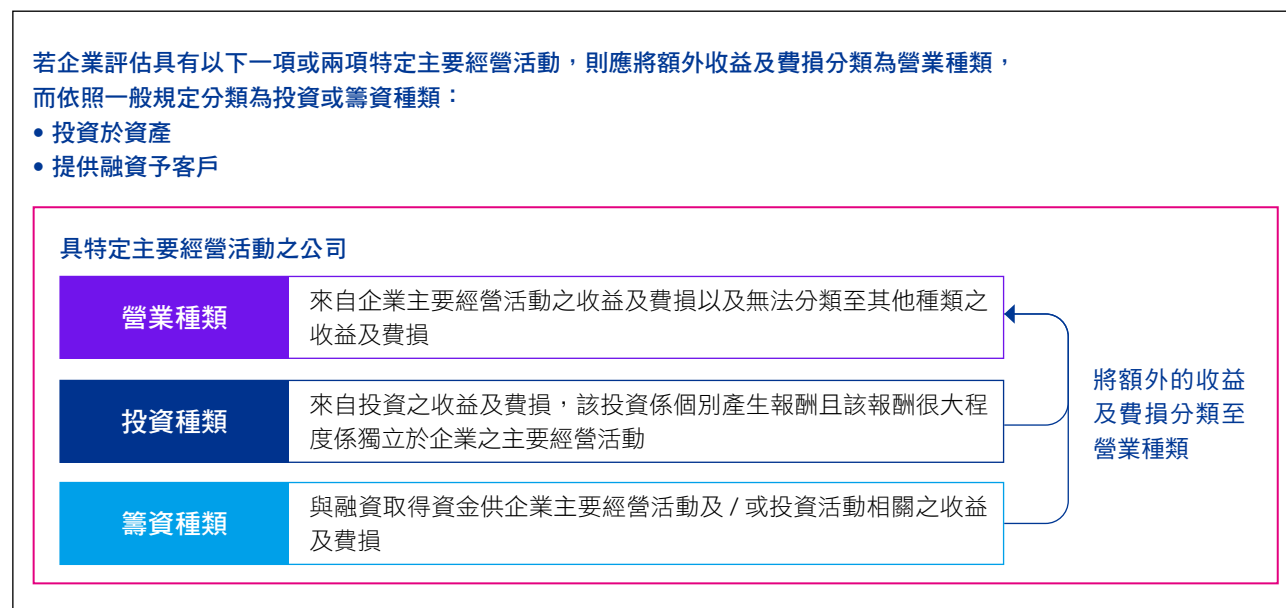
圖三、來自負債之收益及費損分類



• 特定主要經營活動（Specific Main Business Activities，以下亦稱 SMBA）

SMBA 係指「投資於資產」（例如不動產公司、保險公司），或「提供融資予客戶」（例如銀行）二類型，所有公司須謹慎評估各類收益及費損屬於哪一種類，其分類將取決於公司是否有 SMBA，若有，根據額外特定規定，則會將一般應分類為投資或籌資之收益及費損項目，分類至營業種類，例如，若一家公司同時銷售商品又提供融資予客戶，那跟涉及融資交易有關的損益，原本符合「籌資種類」定義，但因為公司有 SMBA，這部分就會被歸類到「營業種類」（請詳圖四）。

圖四、具特定主要經營活動之收益及費損分類



企業是否具有 SMBA，應以報導個體角度評估，集團 SMBA 之判斷可能與個別企業不同，因此收益及費損之分類結果可能有所差異，換言之，每家公司都必須自行評估，不一定會與集團一致。舉例來說，集團本身以汽車製造為主要業務，惟某一子公司專門投資房地產，該子公司於自身財務報表評估其將資產投資作為 SMBA，然而，在合併財務報表中若經判斷房地產投資並非主要業務，則集團損益表需要進行額外之合併調整，必須將子公司的租金收入，「營業種類」重新分類到「投資種類」後，再計入集團合併損益表。

• 兩個新的小計

IFRS 18 要求損益表必須列示兩個新的必要小計：「營業損益」及「籌資前稅前損益」。國外現行實務中編製的損益表，許多公司並未揭露「營業損益」，但 IFRS 18 明確規定這是必須列示的小計；另一個必要小計是「籌資前稅前損益」，概念是將營業種類與投資種類的損益合計，以提供更完整的財務績效資訊。

順帶一提，現行實務中，主要經營活動為投資之控股公司，通常會將相關投資收益及費損列示在營業利益之上，然而，依照 IFRS 18，控股公司於編製個體財報時，採用權益法處理之投資收益應列報於投資種類，不允許分類為營業種類，此意味著，採權益法認列被投資者之損益份額不再屬於營業利益的一部分，而應在「投資」種類中列示，此將使財報呈現方式與現行做法有所差異，因此，投控公司需要思考如何在遵循 IFRS 18 的同時，又不讓使用者看得霧煞煞。新增小計是個好方法！IFRS 18 允許將投資收益置於臨近營業利益小計的位置，並額外列報「營業淨利及權益法投資之收益及費損」小計，此方式就可兼顧資訊完整性與保留現行使用者熟悉的閱表習慣。

• 營業費用之分析

依 IFRS 18，公司於呈現營業費用之分析時，必須選擇最能提供有用資訊的結構性彙總方式，可自行選擇按功能別、性質別或混合基礎別列報，但各期間但需保持一致性，這不是隨意選擇，是公司要決定一個最適合的方式，而且決定後不能隨意更動。為給予我國企業亦得依其營業特性選擇採用分類及列報方式之彈性，編準預計修改方向為，將現行「應」以功能別為分類基礎之規定，修正為「原則」以功能別為分類基礎，讓企業在合規下仍保有選擇空間。

• 管理階層定義之績效衡量（以下稱 MPM）

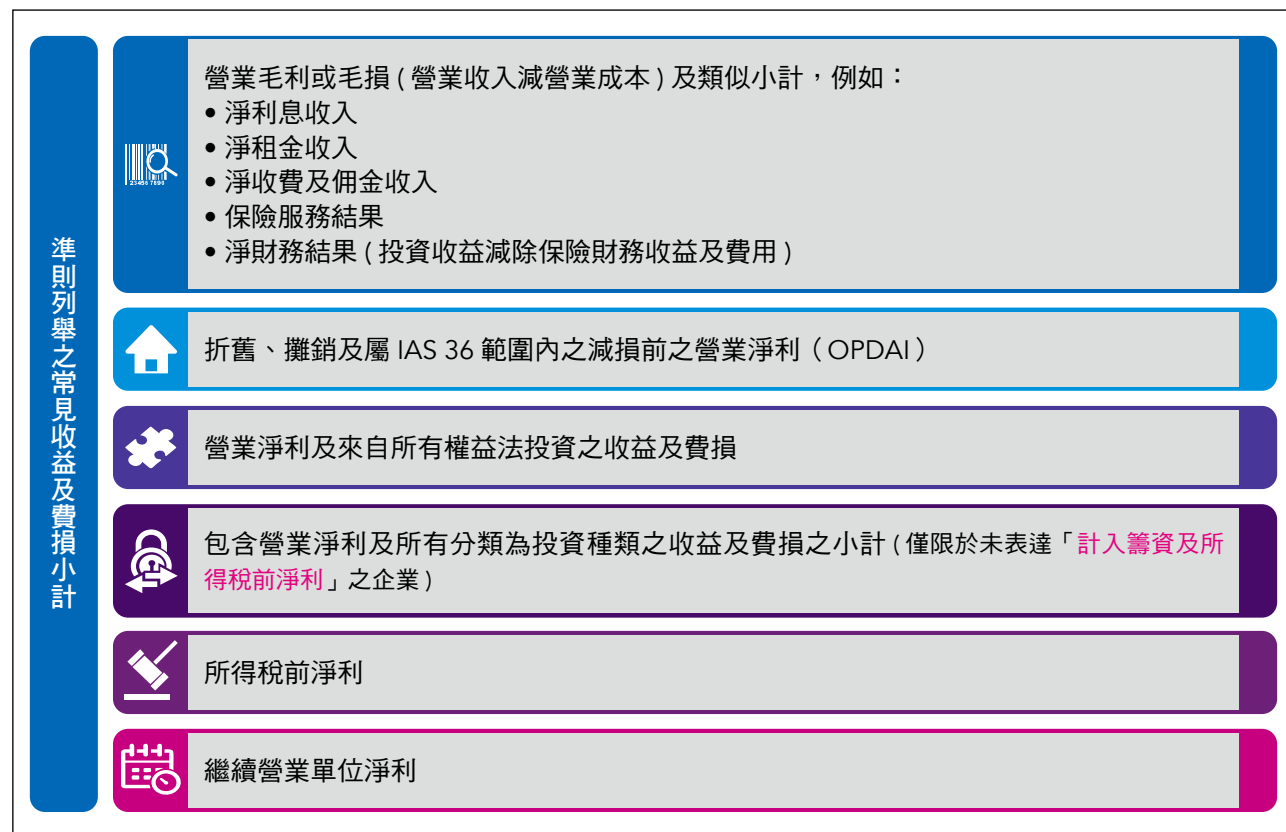
IFRS 18 新增 MPM 的揭露規定，舉例說明，公司於法說會或記者會的財務文件中，常會放入一些損益指標（如 EBITDA），以傳達管理階層對企業整體財務績效某一層面之觀點，這些指標通常經過加減調整，在損益表並未直接顯示，但公司卻用來與投資人溝通，因此準則要求必須在附註中揭露並說明，並調節該 MPM 至準則所規範最接近的總計或小計。

需注意，IFRS 18 第 118 段所列舉之常見收益及費損小計，不視為 IFRS 18 下之 MPM，損益表已有的小計項目亦不在 MPM 範圍內，此外，與收益及費損加減調整無關的指標（如客戶滿意度統計資料），亦非 MPM。

• 彙總與細分

IFRS 18 要擺脫報表只是擺數字，更強調資訊必須具備結構性。相較於 IAS1，IFRS 18 對主要財務報表及附註之角色提出更多規範，並引入明確定義及補充說明，以協助企業判斷重大資訊的最佳呈現位置。企業在揭露資訊時，應依共同或非共同特性（如性質、功能、規模、地理位置、監管環境）進行彙總與細分，讓投資人看得懂。由於主要財務報表之角色僅係提供有用之結構性彙總，因此單行項目可能涵蓋不同特性的內容，因此，需於附註進一步細分，以確保重大資訊完整揭露，並提升報表清晰度，投資人才能受益於更細分的資訊。

圖五、常見之收益及費損小計



對於標示為「其他」的項目，企業應重新檢視其內容，避免模糊化。IFRS 18 不鼓勵使用「其他」作為新揭露項目的標示，應盡可能採用更精確的描述，如「其他營運費用」或「其他財務費用」。

三、實務關注之熱門議題

對出口導向企業而言，外幣兌換損益是財務報表中極具敏感度的項目，投資人也十分關注企業如何分類兌換損益，尤其半導體、電子業因大量美元計價，匯率波動會顯著影響獲利。現行做法下，企業係以單行項目將「外幣兌換損益」列在「營業外收入及支出」項下，與業內損益分開。

• IFRS 18 外幣兌換差額之規定

兌換損益的分類方式將有重大改變，新規定要求無需過度成本及投入下，兌換差額必須跟隨產生匯率變動的貨幣性項目 (資產或負債) 進行分類，例如，若匯差源自應收帳款，則應分類至營業種類；若匯差源自債券投資，則應分類至投資種類；若匯差源自借款，則應列入籌資種類，此方式將使財務報表更能真實呈現匯率波動對各類業務活動的影響。惟若涉及過度成本或投入，則分類至營業種類。需注意，證交所發布的 IFRS 問答集已說明，企業不得未行評估，而逕以現行資訊系統無法區分為由，即主張涉及過度成本或投入。

為確保企業在編製財報時有明確的依據，編準修訂損益表的方向，已區分三個種類，且每個種類均包含「淨外幣兌換利益 (損失)」項目。此外，預期主管機關在修訂科目代碼表時，應會同步針對這三個種類設置對應的兌換損益會計項目，以符合 IFRS 18 對兌換差額分類之要求。

• 集團間外幣應收付款項兌換損益

於 2025 年 9 月國際財務報導準則解釋委員會 (IFRIC) 會議中討論，儘管合併財務報表已將集團內交易沖銷，但集團間借貸所產生的外幣兌換差額無法銷除，如何在合併損益表中進行分類成為關注焦點。初步觀點偏向營業種類，但未排除依交易實質判斷之觀點，後續將視 IFRIC 的決議。

• 所得稅之兌換損益種類

現行實務中，部分公司會將當期所得稅所產生的外幣兌換差額，列報於稅前淨利前之「兌換損益」中，另部分公司依現行 IAS 12 第 78 段規定，將遞延所得稅項目所產生的外幣兌換差額，與遞延所得稅費用 / 利益混合表達。

需特別留意的是，IAS 12 第 78 段已配合 IFRS 18 修改，新規定要求當期及遞延所得稅費用 / 利益及其相關外幣兌換差額，應分類至「所得稅種類」，此意味著採用 IFRS 18 後，必須針對財報表達方式進行調整。

四、對企業的挑戰與應對

IFRS 18 將影響跨行業之所有公司，IFRS 18 對企業的影響，不只是會計部門的事，需要跨部門合作，方能調整財務報導流程，以確保能追蹤並蒐集更細分之資訊，並讓同一科目可正確歸屬到損益表的不同種類。公司應密切關注新規定的細節，且跟進 IFRS 18 的最新實務討論，並將這些觀點應用到實際交易。

IFRS 18 還可能牽動企業所簽訂的各類合約條款，只要涉及「損益小計」，都必須清查是否受到新規定影響，建議企業全面盤點合約，以檢視所有涉及損益指標的條款，確認是否需重新定義或修訂。

企業必須特別注意對外溝通的場合裡，所使用的績效衡量有哪些，辨認所有受 IFRS 18 揭露規定之 MPM 都有完整揭露。自 IAS 1 至 IFRS 18，損益表呈現邏輯已經出現重大轉變，公司須提前與投資者溝通這些變化，確保投資者和其他利害關係人真正理解新的損益表結構，避免因資訊落差造成誤解。

五、結語

由於新準則大刀闊斧地改變了損益表的表達方式，公司需要認真面對新舊準則的差異，並重新檢視每一筆收益及費損到底應歸在哪類，尤其是現行列報於「營業外收入及支出」之項目，需要來場大風吹，各自分類至正確的種類。需注意，IFRS 18 並未修正其他綜合損益及綜合損益總額。除此之外，公司還得重新思考財報中彙總項目是否足夠相似、決定營業費用要怎麼表達、及辨認公司在個別層級與合併層級下，主要經營活動是哪些等。因此，儘管國內主管機關已決定延後一年適用，但準備工作絕刻不容緩！

2025 TSIA 年會暨 半導體獎頒獎典禮活動報導

《強化台灣半導體產業韌性，鞏固全球領導地位》

■ TSIA / 石英堂 協理



台灣半導體產業協會 (TSIA) 於 10 月 23 日假新竹國賓大飯店舉辦 2025 TSIA 年會，大會由理事長侯永清 - 台積電資深副總經理暨副共同營運長致詞揭開序幕。

侯理事長於致詞中表示，在充滿挑戰與變動的 2025 年，雖然面臨諸多壓力與考驗，台灣半導體產業依然展現強勁實力，持續穩居「製造第一、封裝測試第一、IC 設計第二」的全球領先地位，預估今年產值將達 6.5 兆新台幣，年成長達 22.2%。

侯理事長特別感謝 5 月 22 日代表 TSIA 出席在青島舉行的世界半導體理事會 (WSC) CEO 大會的理監事及 JSTC 委員，積極促進 TSIA 與國際之交流及合作，爭取並捍衛台灣半導體廠商的權益。

侯理事長表示 TSIA 長期致力於產學鏈結與人才扎根，不定期舉辦校園演講與產學交流會，積極推動跨領域人才流動，鼓勵各領域的年輕學子加入半導體產業。2025 年 TSIA 半導體獎共有來自 5 所大學的 12 位新進研究人員及博士研究生獲獎，這些新生代的投入，將為產業注入更多創新動能。

面對全球氣候變遷與永續發展的壓力，TSIA 會員公司已於今 (2025) 年再次發表「自主節能減碳宣言」，承諾削減範疇一製程溫室氣體排放、全面導入能源管理系統降低範疇二能源使用之碳排放、以及偕同供應商合作降低範疇三碳排，致力於在維持世界級創新與生產力的同時，將對環境的影響降至最低。



▲ 侯永清理事長

TSIA 去年新成立的「設備委員會」，就先進封裝測試、機台節能管理、及重要零組件優化等主題進行經驗分享與技術討論。為鼓勵學界參與半導體設備的創新與優化及培養半導體設備零組件相關人才，特別設立「TSIA 半導體設備創新獎」，期盼藉由產學合作，推動設備效能與製程效率的持續提升。唯有持續強化本土關鍵技術與製造能力，推動上中下游更緊密的合作，台灣才能實現真正的自主發展與提升抗風險韌性。

今年主題演講特別邀請和碩聯合科技董事長童子賢主講以「產業發展與世界局勢」為題。童董事長指出，人類五千年開採黃金僅 17 萬噸，總值約 19 兆美元，相當於中國一年的 GDP，但真正創造人類財富與文明進步的力量，來自科技創新與產業發展。童董事長表示，全球經濟以服務業為主，但製造業仍是國家競爭力的根基；「產業是數十年乃至百年的成果累積」。台灣未來除了持續掌握 AI、電動車等先進製造，也應積極培育高階服務業，包括資訊、金融、觀光與教育等領域。童董事長並進一步指出，永續發展須重視法規、人才與能源。新科技與新服務的成長，需有健全的法律、金融與創投架構支撐，法治與人治之間有如雲泥之別。人才的培育，不僅來自教育，也需保持開放的文化以「栽植梧桐，招來鳳凰」，為台灣產業的長遠繁榮奠定基礎。



▲ 主題演講和碩聯合科技童子賢董事長

會中同時舉行 2025 TSIA 半導體獎頒獎典禮，今年具博士學位之新進研究人員得獎者如下：國立陽明交通大學資訊工程學系吳俊峯博士、國立成功大學電機系范銘彥博士。博士研究生得獎者如下：國立臺灣大學重點科技學院元件材料與異質整合博士學位學程呂育誠同學、國立臺灣大學光電工程學研究所林禹彤同學、國立陽明交通大學材料科學與工程學系林懷恩同學、國立成功大學電機系微電子所洪浩君同學、國立陽明交通大學前瞻半導體研究所徐承煒同學、國立中山大學材料與光電科學學系郭娟璋同學、國立中山大學電機工程學系郭庭慈同學、國立清華大學電機工程學系溫戴豪同學、國立臺灣大學電子工程研究所黃柏崴同學、國立陽明交通大學國際半導體產業學院楊宗穎同學。其中國立中山大學材料與光電科學學系郭娟璋同學、國立中山大學電機工程學系郭庭慈同學為女性得主，近年女性研究者在半導體領域都有非常傑出的表現，期待能有更多女性研究人員投入半導體研究。理事長特別祝賀今年的得獎者，期待這些新生代的投入，為產業注入更多創新動能。



▲ 2025 TSIA 半導體獎得獎者與理事長合影



▲ 論壇與談貴賓

由聯發科技與籌畫，以「深化台灣半導體產業優勢，持續引領全球發展」為主軸之論壇，特別邀請國立陽明交通大學副校長暨產學創新研究學院院長孫元成博士及擔任主持人。孫副校長說明隨著摩爾定律逼近極限，全球正邁向以 3Dx3D 系統整合與 AI 運算為核心的「超摩爾時代」(Super-Moore Era)。未來的晶片不僅仰賴製程微縮，更強調透過 3D 堆疊、先進封裝與跨域整合來提升效能與功能，台灣在晶圓代工與封裝測試的基礎上，應深化 (3Dx3D) * AI 的融合優勢，推動 Edge AI、Smart IoT 與 Data Center 等應用發展，並發展新材料、神經形態與低碳運算等前瞻半導體技術。

與談人聯發科技吳慶杉副總經理表示台灣半導體產業具備領先的先進製程技術、完整的 IC 設計能力以及高度垂直整合的供應鏈體系。隨著雲端與 AI 應用迅速擴展，亟需整合型跨領域人才，如何培育兼具技術專業與全局思維的人才，將成為台灣半導體產業持續保持競爭力的關鍵。

臻鼎科技集團沈慶芳董事長指出面對 AI 晶片高效能運算需求攀升，異質整合封裝技術已成為關鍵驅動力。未來，透過自動化生產與智慧製造的導入，可有效提升人均產值與整體生產效益，實現 PCB 與半導體產業共創價值、共同成長的目標。

台積電柯宗杰資材管理處長表示台積電憑藉製程技術與資材管理的持續創新，成功維持全球半導體製造的領先地位。透過供應鏈管理與風險控管，有效提升產業韌性與穩定性。展望未來，台灣需持續強化核心競爭力，推動全球化發展，透過創新與合作，始能鞏固台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

京元電子張高薰總經理則提出測試產業的新定位構想：從被動支援的供應鏈角色，轉型為參與製程整合與技術創新的關鍵夥伴，透過工程化、技術合作與永續思維，強化整體產業價值鏈。

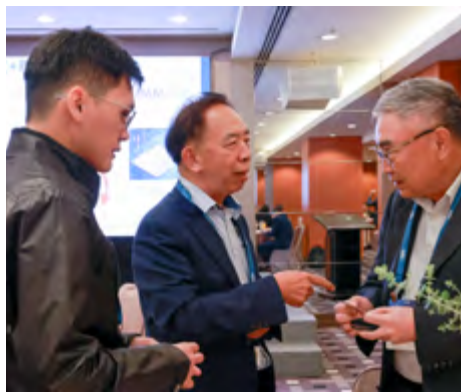
工研院蘇孟宗資深副總暨協理表示台灣應掌握核心製造商海外擴張，共築供應鏈新生態的戰略先機，政府透過晶創計畫支持，在工研院打造完整晶片生態系，併重先進與成熟製程，加速新興應用落地，台灣與世界共創無限可能。

主持人及與談者一致認為，因應未來雲端與 AI 應用迅速擴展，惟有透過持續技術創新與發展，供應鏈的垂直整合，培育整合型跨領域人才及政府的政策協助，才能持續深化台灣半導體產業優勢，引領全球發展。

今年共計有近 450 人與會，感謝所有贊助廠商的贊助與支持及所有會員的熱情支持與參與，讓此次年會能順利圓滿舉行。

活動花絮





我國參加第 26 屆政府間半導體會議 (GAMS) 情形

■ 經濟部國際貿易署



▲ 台灣 GAMS 及 JSTC 代表團合影

壹、會議簡介

一、目的

政府間半導體會議 (Governments / Authorities Meeting on Semiconductors, GAMS) 是有關半導體產業的政府間國際會議，會員包括美國、歐盟、日本、韓國、中國及我國 (前 4 國為創始會員)。GAMS 會員每年針對世界半導體理事會 (WSC) 提出的各項建言逐一研商，以期解決半導體產業所遇困難，建立有利產業發展的公平競爭環境，排除不必要的貿易障礙及促進半導體產業貿易。

第 26 屆 GAMS 於本 (2025) 年 11 月 4 日至 6 日在韓國釜山舉行，討論議題包括區域支持計畫、加密法規、關務、化學品管理、全球供應鏈、半導體人才培訓等 2025 年 WSC 聯合聲明及建言內容。

二、會議過程

本屆 GAMS 會議主席為韓國產業通商資源部高科技產業署署長 Woohyuk Choi，我國由經濟部國際貿易署胡副署長啟娟偕同仁及其他機關 (構) 成員出席。

我國代表團行程包括 11 月 4 日出席 GAMS 區域支持計畫及加密法規研討會、11 月 5 日進行雙邊會談、及 11 月 6 日出席 GAMS 會議。

貳、11 月 4 日研討會情形

一、區域支持計畫研討會

1. 依序由中國、我國、歐盟、日本、韓國、美國進行區域支持計畫第三期執行情形 (每個成員共二項計畫) 口頭報告。
2. 各成員續就 WSC 就政府資金移轉最佳實務擬定的 2 項關鍵原則 (透明性原則及市場化原則) 及區域支持計畫資訊分享十周年檢視進行意見分享。

二、加密法規研討會

各 GAMS 成員針對後量子運算加密法規及各 SIA 成員就其它影響半導體的法規或標準進行說明及分享。

參、11 月 5 日雙邊會議情形

我國與其他 GAMS 會員進行雙邊會談，針對電子傳輸免徵關稅、區域支持計畫資訊分享及半導體人才培訓等議題交換意見。

肆、11 月 6 日 GAMS 大會

- 一、本年因主辦國韓國於會議前數日先行提供主席聲明草案供其他成員檢視，並於雙邊會議時交換草案意見，爰實際討論時各會員就文件架構並無太多歧見，大多係處理美歐中關切議題 (區域支持計畫、加密法規、全球供應鏈、多邊貿易體系) 段落文字，在各方相互妥協下，最終仍就主席聲明內容達成共識。
- 二、本年 WSC 建言包括請 GAMS 蒐集專利訴訟的統計資訊，係我半導體產業主要訴求，在日本及韓國支持下，首次納入主席聲明。



2025 GAMS / JSTC 會議報告

■ TSIA / 陳淑芬 國際事務執行處長



▲ 台灣 GAMS 及 JSTC 代表團合影

2025 年 11 月的 GAMS 及 JSTC / TF 會議已於 11 月 3 日到 11 月 7 日於韓國釜山舉行。GAMS 會議由韓國政府主持，JSTC 會議則由 KSIA 的 JSTC 主席 Hyouk Woo Kwon (Samsung) 擔任主席。主要議題包括政府支持措施、全球供應鏈、勞動力發展、智財權保護、加密產品的市場進入、產業相關標準、環安衛、關稅問題等。相關會議時程如下：

日 期	會 議
11 月 3 日	各委員會及工作小組會議
11 月 4 日	各委員會及工作小組會議、JSTC 雙邊會議、GAMS Regional Support Workshop、GAMS Encryption Workshop、GAMS Reception
11 月 5 日	JSTC 會議、GAMS 雙邊會議
11 月 6 日	GAMS 會議、GAMS 晚宴
11 月 7 日	JSTC 會議

台灣政府由經濟部國貿署胡啟娟副署長率團參加 GAMS 會議；TSIA 則由台積電張宇恩處長及瑞昱黃依璋副總共同率領本會 JSTC 代表團參與各項會議及雙邊交流，成員包括 TSIA 吳志毅執行長、台積電房漢文處長、聯電殷嘉偵處長、台積電文黃瑋技術經理、TSIA 呂慶慧環安顧問（工研院正工程師及業務經理）、TSIA 法律顧問 Christopher Corr、TSIA 陳淑芬國際事務執行處長、以及 TSIA 陳昱錡資深經理。

相關議題重點摘要如下：

■ Customs & Tariffs

a. WTO Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmission

WSC 歡迎 WTO 成員在 2024 年第十三屆部長級會議上作出的維持暫緩徵收關稅 (Moratorium) 的決定，但也對該暫緩措施可能最早於 2026 年 3 月 31 日到期表示擔憂。WSC 在 2025 年 5 月重申其呼籲，要求 GAMS 與其他 WTO 成員合作，推動延長該暫緩措施，並制定一項 WTO 協定，以確保與半導體相關的資料永久免於關稅和海關程序。

主席還報告 WSC 正在起草清單，列出若 WTO 暫緩措施未獲持續將受影響的各類半導體跨境傳輸資料種類。工作小組主席將起草一封關於暫緩措施的致 GAMS 信函，並在 11 月底前整合意見並分享最終版本。

b. Customs Classification

根據主席 ESIA，歐盟海關已向世界海關組織 (WCO) 提交建議，修改 HS8534 將智慧印製電路板 (Smart PCBs) 納入其中。ESIA 會試著尋求更多相關資訊。

c. Digitalization of Customs

工作小組正在監測 WSC 各地區海關在數位化方面的相關措施，這些措施可能會對進出口商在電子海關系統中提交的資料的使用和保護產生影響。工作小組目前正進一步識別潛在的問題及可採取行動的機會。主席也匯整並分享了 WSC 各地區海關數位化的概況，以及各地區現有的數位海關資料保護措施。各協會將繼續關注所在地區海關數位化相關措施的進展，並在下次的 JSTC 會議上回報。

■ Market & Growth

主席 CSIA 說明已更新 WSC 市場報告，新增了按地區和技術節點劃分的 2024 年半導體製造產能資料。該資料由 ESIA 和 SIA 提供。ESIA 和 SIA 將在 12 月中前提出方案，以確保今後能夠持續更新這些資料。

■ Workforce Development

各協會同意在下次會議之前，提出新的半導體勞動力發展倡議的想法，並計劃在下次會議時，分享其所在地區主要大學中進行的相關演講、講座或研討會的情況，以及此類活動的成果或成效。

■ Regional Support

關於 WSC 提交的《政府 / 主管機關資金轉移關鍵原則》，2024 年的 GAMS 柏林會議上未能達成共識，美國 SIA 進而提出 2 項註腳進一步界定原則所涵蓋的地區支持計畫的範圍，CSIA 隨後也建議新增兩項原則（1. 自由貿易；2. 非歧視）。惟因各協會對《WTO 補貼與反補貼措施協定》（SCM 協定）的理解並不一致，認為 WSC 並非 WTO 的替代平臺，也不是討論此類議題的適當場所，因此進一步尋求 GAMS 的看法。

在 11 月 4 日舉行的 GAMS Regional Support 研討會上，中國 GAMS 表示支持 CSIA 新增的兩項原則。美國 GAMS 則表示支持 WSC 兩項原則的精神，但無法正式認可，因為僅限於《WTO 補貼與反補貼措施協定》第 1.1 條定義範圍的轉移，無法實現所需的透明度；同時對美國 SIA 提出的註腳表示讚賞。最後美國 SIA 請求 GAMS 提供進一步澄清，SIA 強調若無政府指導，WSC 無法進一步討論。

11月4日的Regional Support研討會上也回顧了過去十年間地區支持計劃資訊分享的三個階段。目前GAMS已暫停對第一、第二階段的資訊交流，預計在此第十次研討會上也將結束第三階段計劃的分析與交流。雖然GAMS對繼續進行資訊分享持正面態度，但對於是否繼續GAMS Workshop或以何種方式進行資訊分享無法達成共識，因此決議在明(2026)年上半年舉辦一次GAMS與WSC的期中會議繼續討論。

各協會同意與各自GAMS就2026年期中會議的結構與時間進行討論，並向所有協會回報。各協會也將向主席SIA分享繼續資訊交流的可能替代形式建議，由SIA在下次的工作小組會議上彙報各協會的建議，以便回報GAMS。

■ Encryption

在11月4日舉行的GAMS Encryption研討會中，JSTC向GAMS提供各地區標準化活動的案例。11月6日的GAMS會議後，GAMS邀請WSC進一步探討影響半導體產業的其他相關法規和標準，並同意於2026年繼續舉辦GAMS研討會討論這些議題。各協會同意於2026年1月底前提交影響半導體產業、值得進一步資訊交流和討論的其他相關法規及標準。JSTC也決定重新向GAMS提出關於PQC的問題，因為這些問題在加密研討會及GAMS主席總結中尚未得到充分回應。

■ Protection of Intellectual Property

a. Patent Quality and Cooperation with WIPO

WSC IP委員會持續討論有關提交專利訴訟資料的益處。JSIA於會議中進一步建議以現有全球專利局用於收集和報告專利資訊(“書目資訊”)給WIPO的標準化格式(“INID代碼”)為起點，在WIPO報告範本中新增基本的專利訴訟指標(例如：提起訴訟的數量、至最終裁決的時間及處理結果)。該方案的優勢包括：

1. 利用專利局已用於向WIPO傳送資料的現有資料收集格式；
2. 最大限度地減少專利局負擔，因為專利權人可在專利表格中補充訴訟資訊，專利局僅需匯總並上報WIPO；
3. 在需要時可保持保密性，因為專利局可按匯總方式上報資料。

由於各國狀況不同，本會、CSIA、ESIA、及JSIA支持或持正面態度；KSIA表示將繼續研究此問題；美國SIA則表示，美國已有多家外部機構收集並匯總基本專利訴訟資料，建議IPC首先鼓勵各GAMS地區公開IP訴訟案件，以提升透明度。同時提出，可能需要各GAMS地區IP專家間的直接交流，以確定後續最佳執行方案。

各協會討論後，同意以下事項：

1. 各協會同意在下次IPC會議前，就2025年GAMS主席總結中提到的聲明：“GAMS歡迎召開技術層面的討論，以便WSC更能闡述其關於專利授權後複審及訴訟資料收集與報告的觀點和建議”提出建議。
2. 各協會在下次IPC會議前，考慮如何邀請產業界及各地區專利局的相關技術專家參與。
3. 在可能且適當的情況下，報告任何關於專利訴訟資訊公開可得性及其是否促進或阻礙產業發展的研究或案例。
4. 報告各地區法院是否存在任何機制或法律要求，須在專利訴訟提起時通知專利局，以避免潛在的重複程式。
5. 考慮是否於2026年6月WSC期間在日內瓦與WIPO舉行會議。



b. TPLF

美國SIA表示，美國GAMS目前無法支持在此議題上增加任何文字。11月6日的GAMS主席總結也未就此議題有任何指示。各協會決定下次IPC會議不討論此議題。

■ Environment, Safety and Health (ESH)

a. GHGs

委員會主席KSIA介紹了關於半導體製造中使用的全氟化合物(PFCs)的工作進展。這類氣體屬於強效溫室氣體(GHGs)，並涉及範圍2(Scope 2)排放。

根據2030年自願減排協議，WSC承諾到2030年實現PFC減排率85%的目標(基線為82.6%)。2024年的PFC資料按照IPCC 2019 Tier 2c方法收集，五個協會在2024年的減排率達84%。WSC也承諾在2026年進行期中審查，以便採納涵蓋範圍1和範圍2排放的更廣泛溫室氣體(GHG)目標。關於範圍2排放(Scope 2)，主席表示，所有協會均已收集到2024年的基於市場的電力排放資料及可再生能源使用比例。鑒於許多公司已承諾在2050年實現溫室氣體淨零排放(Net Zero)，WSC各協會一致同意考慮採用低碳電力(LCE)比率作為WSC的潛在指標。

在11月7日JSTC會議中，JSIA詢問在資料收集範圍內涵蓋了多少晶圓廠(fab)，以及這些晶圓廠在WSC成員公司所有或運營晶圓廠總數中的覆蓋比例，並要求ESH主席在下次JSTC會議上報告此情況。

各協會討論後重點事項包括：

1. CSIA應確認其會員企業是否同意提供減排率資料並回報結果；若獲同意，應於2026年1月31日前提交2023年和2024年資料。
2. 各協會應根據截至2月底收集的資料，制定範圍2自願協定的時間表和目標，以便在3月會議上討論。
3. 為進一步改進PFC排放計算方法，本會將根據其同意收集的資料，於下次會議提出一項關於區分“含碳源”和“不含碳源”的CVD工藝排放差異化計算方案。

4. ESH 委員會應討論並回應 JSIA 提出的關於資料收集所覆蓋晶圓廠數量及其在 WSC 成員公司晶圓廠總數中覆蓋比例的詢問。

b. Chemicals

以美國 SIA 為首的半導體 PFAS 聯盟分享了當前工作概況，其中包括 PFAS 排放釋放模型開發進展、以及三個初步概念 PFAS 排放模型（等離子刻蝕與沉積 (PED) 模型、熱傳導流體 (HTF) 模型、光刻模型）等。各協會同意考慮一條前進路徑，以評估在自願 PFAS 計畫下收集資料的準備情況。工作小組還討論了建立 WSC 內部化學品跟蹤試算表的價值，包括關注物質及類別，並提供化學 ID（如適用）、各地區監管狀態、與半導體供應鏈、製造或產品的相關性等。

c. Water

工作小組同意了用於案例研究的回收率計算公式。目前資料收集情況：

- TSIA、JSIA、KSIA、SIA：已完成
- ESIA：進行中
- CSIA：與會員公司溝通收集資料

各協會討論後確定水資源相關指南和定義，並將於 2026 年 1 月 31 日前根據確定的指南修訂資料範本。CSIA 必需於 2026 年 2 月 28 日前回報其與成員的溝通情況。

■ Anti-Counterfeiting

主席 ESIA 指出，各協會同意進一步修改 WSC 反仿冒白皮書，尤其是縮短白皮書篇幅，以及增加更多圖表，例如海關查獲的仿冒晶片數量等資訊。各協會同意在 2026 年 3 月 JSTC 會議前對 ESIA 的修正版本提供意見，以便在下次會議中定稿。

■ WSC 2.0

工作小組檢討 2025 年青島 WSC 會議，認為討論保持非政治性，內容在地緣政治背景下有所限制，但提供了中國半導體和汽車產業的資訊等，總體而言，會議富有成效。展望 2026 年的 WSC 會議，相關建議包



括：內容和形式應以 CEO 興趣為主要關注點、縮短議題報告時間、增加討論和交流時間、規劃專題討論，促進互動和對話、未來議程應優先考慮產業發展主題，如半導體市場展望、預測及人才發展等。由於明年 WSC 會議地點在日內瓦，更可利用地點優勢，考慮邀請政府代表及其他行業協力廠商參與。各協會同意向 ESIA 提交進一步建議，同時提交初步的可能出席的 CEO 名單。

■ Global Supply Chain

主席 CSIA 向 JSTC 報告了全球供應鏈議題的匯總報告，總結了當前進展，並提出了下一步建議。經過討論，JSTC 同意各協會繼續審查現有出版物。關於評估政府或相關機構政策在維持或增強半導體全球供應鏈韌性方面的努力，JSTC 並未達成共識。各協會同意繼續提供各自地區為維持半導體全球供應鏈韌性所採取的努力和 / 或行動總結，並提交最多兩份與全球供應鏈相關的現有出版物，重點關注市場力量、產業政策及貿易政策等因素對當前全球供應鏈的影響。

■ Future Meetings

2026 年 3 月的 JSTC 會議由 TSIA 主辦。2026 年 6 月的 WSC / JSTC 會議由 ESIA 主辦。2026 年 10 月的 GAMS / JSTC 會議由 JSIA 主辦。

基於 JSTC 改善會議效率的努力，此次會議的主辦單位 KSIA 特別在 GAMS 會議時邀請波士頓顧問公司 (BCG) 專家以“人工智慧時代的半導體產業成長”為主題進行分享，也以“產業與政府在人工智慧與半導體共同成長中的角色”為主題進行論壇。本會由瑞昱黃依璋副總代表出任與談人，分享“隨著人工智慧的興起，半導體設計需要哪些技術創新、以及設計與製造之間的合作結構又會如何演變”。黃副總精闢的見解及專業意見獲得與會全球業界及 GAMS 政府代表的高度認同及尊敬，不僅展現台灣代表團的實力，也提升了台灣的專業形象。

本會還要特別感謝經濟部國際貿易署胡啟娟副署長及相關政府機關的代表們在 GAMS 相關會議的準備及付出，本會也感謝在繁忙公務之餘，願意抽出時間協助 TSIA 參與 WSC / GAMS 各項議題討論的所有業界代表（包括台積電、瑞昱半導體、聯電、工研院），這種服務公眾、為國家及產業奉獻之心，本會深表佩服及感激。

TSIA 會員若是對於 WSC / GAMS / JSTC 相關議題有興趣或有疑問，歡迎秘書處聯絡。



2025 GAMS 環安小組會議記要

■ TSIA / 呂慶慧 顧問

2025 年世界半導體協會環安委員會會議於 11 月 1-5 日在韓國釜山舉行。本次會議討論議題包括 GHG (溫室氣體)、化學品、水以及安全與健康。各項重點如下說明：

■ GHGs (溫室氣體)

GHG 工作小組主席首先報告與半導體製造相關的高暖化潛勢溫室氣體—全氟化合物 (Perfluorinated Gas Compounds, PFCs) 之減量進度，以及 Scope2 排放管理現況。

依據 2030 年自願協議 (voluntary agreement)，WSC 承諾相較基準年 (82.6%)，於 2030 年達成 PFCs 減排率 85% 的目標，並以持續導入最佳實務 (Best Practices) 作為執行路徑。2024 年 PFC 資料依據 IPCC 2019 Tier 2c 方法學採集，使用更新後之 Default Factor 及 IPCC AR6 GWP 值。依五大協會提交資料，2024 年整體減量率已達 84%。但 CSIA 未提交資料。工作小組同意由 CSIA 鼓勵其會員企業直接回報減量數據，以提升資料透明度。待中國資料補齊後，便能達到全區域完整參與數據統計。

WSC 亦承諾將於 2026 年進行審查，並研議採納涵蓋 Scope1 與 Scope 2 的更廣泛的 GHG 目標。ESH 委員會已同意建立相關目標設定架構 (framework)，未來將納入 N₂O 與 Heat Transfer Fluids (HTF) 的排放資訊。

在 Scope2 排放部分，主席表示所有協會已完成 2024 年依市場基礎方法 (market-based method) 之排放統計，並已提交再生能源 (Renewable Energy) 占比。

會中並正式啟動將 Scope 2 納入自願協議的討論。考量全球半導體企業多已承諾 2050 淨零排放 (Net Zero GHG emissions)，所有協會一致同意評估採納低碳電力 (Low Carbon Electricity, LCE) 比率作為 WSC 指標。鑒於各區域情況不同，各協會將回到區域內進行討論，決定是否可採納 LCE 目標。若取得會員共識，將於下次會議提交目標草案，同時更新與執行 Best Practices 文件。

在 11 月 7 日 JSTC Wrap-up Meeting 中，日本詢問目前資料覆蓋範圍，並要求 ESH 委員會於下次 JSTC 會議回報：目前資料收集涵蓋多少晶圓廠 (fabs)，以及這些 fab 在 WSC 會員所有或運轉 fab 中的覆蓋率。

■ Chemicals

台灣、歐洲、日本與美國先後報告區域化學品政策與法規更新進度，而歐洲與美國亦簡報最新化學品研究與開發進展。各區域同意未來持續資訊共享並定期更新相關進度。

工作小組確認半導體產業對 PFAS 使用與排放理解仍有限，因此 PFAS 議題將持續作為重點工作方向。美國作為 Semiconductor PFAS Consortium 的領導單位，介紹目前已執行、進行中以及規劃中的研究內容，並更新 PFAS 排放模型開發進展。

模型涵蓋三種概念性 PFAS 釋放模式：

1. Plasma Etch & Deposition (PED) 模型
2. Heat Transfer Fluids (HTF) 模型
3. Photolithography (光阻) 模型

這些模型旨在根據排放因子與釋放路徑評估 PFAS 排放。各協會同意評估採行新的執行路徑，包括是否具備蒐集並整合數據之能力，以確保自願 PFAS 計畫得以持續推進。



此外，為強化資訊共享並追蹤面臨現行或潛在管制之物質，工作小組將評估建立 WSC 內部參考用的追蹤工具 (例如內部使用的 spreadsheet)，內容包括：

1. 重要物質清單 (含化學身份資料)
2. 各區域監管狀態
3. 與半導體供應鏈、製程或產品相關性

■ Water

半導體產業為高度用水產業，因此水資源管理被視為 ESH 委員會的關鍵議題。委員會強調業界須採取跨利害關係人協作方式，提升水資源效率並降低風險。

Water 工作小組已同意再利用率計算公式並應用於案例研究。目前已有四個協會 (台灣、日本、韓國與美國) 完成 2024 年資料收集並執行案例研究；歐洲表示將持續推動資料收集，而中國也將研議收集資料的可能性。此外，歐洲分享了歐盟水資源政策與框架資訊。

■ Safety & Health

工作小組持續收集與分析 2024 年安全與健康數據，涵蓋全球不同區域的 Recordable Case Rate 與 Severity Rate。這些資料有助於強化業界可信度並推動安全最佳實務共享。

所有 2025 年 2 月會議決議之行動項目均已完成。歐洲已於 2 月發布資料收集模板、5 月完成回收並於 6 月與所有協會分享統整結果。

參加 SIA Awards Dinner 心得分享

■ TSIA / 陳淑芬 國際事務執行處長



美國半導體協會 (SIA) 的 Robert N. Noyce Award 今年頒給台積電董事長暨總裁魏哲家，以及台積電前董事長劉德音。本人代表 TSIA 參加在 San Jose 舉辦的頒獎晚宴，並在晚宴開始前，利用機會上前代表吳志毅執行長，親自向兩位協會前理事長表達祝賀之意。

SIA Awards Dinner 於 11 月 20 日在美國加州聖荷西市的 Signia by Hilton hotel 舉行，頒獎典禮在晚宴中進行，晚宴前後並規劃 Reception 提供與會賓客互動交流的機會。

晚宴由 SIA President - John Neuffer 開場並擔任主持。首先頒發大學研究獎，分別由康乃爾大學的 Huili Grace Xing 教授以及密西根大學的 Todd Austin 教授獲獎。接著由 SIA 甫上任的理事長 - AMD CEO, Lisa Su 致詞後，隨即邀請 Broadcom 的 President and CEO - Hock Tan 擔任頒獎及引言人，進行 SIA Robert N. Noyce Awards 的頒獎典禮。劉德音前董事長及魏哲家總裁分別上台領獎並發表感言，之後與 SIA 新任的理事長 - Lisa Su 進行座談。

頒獎晚宴眾多業界大老齊聚，場面盛大，兩位得獎人真摯且風趣的感言，及與 SIA chairman - Dr. Lisa Su 的專業對談，內容豐富、高潮迭起，讓現場近 700 位的業界人士掌聲不斷。據聞今年頒獎晚宴的與會人數創下歷年新高，本人能夠恭逢其盛，親自向兩位前理事長恭喜，深感榮耀。本人除了親自向劉德音及魏哲家兩位前理事長致意外，也與與會的美國 SIA 業界代表、SIA 工作人員、以及台積電台灣及美國的與會人員交流互動。

Robert N. Noyce Award 被譽為半導體業最高榮譽。獎項是為紀念半導體產業先驅、快捷半導體和英特爾共同創辦人諾伊斯所設立的，旨在表彰於技術或公共政策領域，為半導體產業帶來傑出貢獻的領導人。本會要在此再次恭喜劉德音及魏哲家兩位前理事長獲此殊榮，TSIA 與有榮焉！



TSIA 2025Q3 IC 產業 動態觀察與展望暨研討會

■ TSIA：工研院產科國際所 半導體研究部



7.2%；IC 製造業為新臺幣 11,372 億元 (USD\$35.4B)，較上季 (25Q2) 成長 6.4%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 26.8%，其中晶圓代工為新臺幣 10,806 億元 (USD\$33.7B)，較上季 (25Q2) 成長 5.7%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 27.0%，記憶體與其他製造為新臺幣 566 億元 (USD\$1.8B)，較上季 (25Q2) 成長 21.2%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 23.9%；IC 封裝業為新臺幣 1,252 億元 (USD\$3.9B)，較上季 (25Q2) 成長 8.4%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 12.4%；IC 測試業為新臺幣 583 億元 (USD\$1.8B)，較上季 (25Q2) 成長 4.5%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 15.4%。新臺幣對美元匯率以 32.1 計算。

工研院產科國際所預估 2025 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 64,825 億元 (USD\$201.9B)，較 2024 年成長 22.0%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 14,320 億元 (USD\$ 44.6B)，較 2024 年成長 12.6%；IC 製造業為新臺幣 43,401 億元 (USD\$135.2B)，較 2024 年成長 26.9%，其中晶圓代工為新臺幣 41,362 億元 (USD\$128.9B)，較 2024 年成長 27.5%，記憶體與其他製造為新臺幣 2,039 億元 (USD\$6.4B)，較 2024 年成長 16.1%；IC 封裝業為新臺幣 4,822 億元 (USD\$15.0B)，較 2024 年成長 13.9%；IC 測試業為新臺幣 2,282 億元 (USD\$7.1B)，較 2024 年成長 14.0%。新臺幣對美元匯率以 32.1 計算。

一、全球半導體市場概況

根據 WSTS 統計，25Q3 全球半導體市場銷售值達 2,084 億美元，較上季 (25Q2) 成長 15.8%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 25.1%；銷售量達 2,835 億顆，較上季 (25Q2) 成長 6.9%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 11.8%；ASP 為 0.735 美元，較上季 (25Q2) 成長 8.4%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 11.9%。

25Q3 美國半導體市場銷售值達 676 億美元，較上季 (25Q2) 成長 22.2%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 30.6%；日本半導體市場銷售值達 113 億美元，較上季 (25Q2) 成長 5.2%，較 2024 年同期 (24Q3) 衰退 10.2%；歐洲半導體市場銷售值達 141 億美元，較上季 (25Q2) 成長 7.2%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 6.0%；中國大陸市場 561 億美元，較上季 (25Q2) 成長 10.2%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 15.0%；亞太地區半導體市場銷售值達 593 億美元，較上季 (25Q2) 成長 19.2%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 47.9%。

二、台灣 IC 產業產值概況

工研院產科國際所統計 2025 年第三季 (25Q3) 台灣整體 IC 產業產值 (含 IC 設計、IC 製造、IC 封裝、IC 測試) 達新臺幣 16,697 億元 (USD\$52.0 B)，較上季 (25Q2) 成長 4.4%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長 20.6%。其中 IC 設計業產值為新臺幣 3,490 億元 (USD\$10.9B)，較上季 (25Q2) 衰退 2.9%，較 2024 年同期 (24Q3) 成長

單位：億新臺幣

2025 年台灣 IC 產業產值統計結果														
	25Q1	季 成長	年 成長	25Q2	季 成長	年 成長	25Q3	季 成長	年 成長	25Q4 (e)	季 成長	年 成長	2025 (e)	年 成長
IC 產業產值	14,888	-0.4%	27.6%	15,994	7.4%	25.9%	16,697	4.4%	20.6%	17,246	3.3%	15.4%	68,825	22.0%
IC 設計業	3,620	8.4%	20.6%	3,595	-0.7%	15.0%	3,490	-2.9%	7.2%	3,615	3.6%	8.3%	14,320	12.6%
IC 製造業	9,683	-2.8%	34.6%	10,686	10.4%	32.4%	11,372	6.4%	26.8%	11,660	2.5%	17.0%	43,401	26.9%
晶圓代工	9,261	-3.3%	37.2%	10,219	10.3%	34.4%	10,806	5.7%	27.0%	11,076	2.5%	15.7%	41,362	27.5%
記憶體與其他製造	422	8.2%	-5.0%	467	10.7%	0.2%	566	21.2%	23.9%	584	3.2%	49.7%	2,039	16.1%
IC 封裝業	1,069	-3.7%	8.3%	1,155	8.0%	13.0%	1,252	8.4%	12.4%	1,346	7.5%	21.3%	4,822	13.9%
IC 測試業	516	-2.4%	6.3%	558	8.2%	15.3%	583	4.5%	15.4%	625	7.2%	18.4%	2,282	14.0%
IC 產品產值	4,042	8.4%	17.3%	4,062	0.5%	13.1%	4,056	-0.1%	9.2%	4,199	3.5%	12.6%	16,359	13.0%
全球半導體市場 (億美元) 及成長率 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,277	15.4%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/11)

單位：億新台幣

2021 ~ 2025 年台灣 IC 產業產值										
	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2025 (e)	2025 (e) 成長率
IC 產業產值	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	64,825	22.0%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,320	12.6%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	43,401	26.9%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	41,362	27.5%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	2,039	16.1%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,822	13.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,282	14.0%
IC 產品產值	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-13.7%	14,478	14.3%	16,359	13.0%
全球半導體市場 (億美元) 及成長率 (%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,305	19.7%	7,277	15.4%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/11)

說明：

- 註：(e) 表示預估値 (estimate)。
- IC 製造業產值 = 晶圓代工 + 記憶體與其他製造。
- IC 產業產值 = IC 設計業 + IC 製造業 + IC 封裝業 + IC 測試業。
- 上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。
- IC 產品產值 = IC 設計業 + 記憶體與其他製造。

台灣半導體產業協會 (TSIA) 於 2025 年 11 月 14 日舉辦「TSIA 2025Q3 IC 產業動態觀察與展望暨專題」研討會，近 100 位會員公司先進報名參加，由市場資訊委員會副主委 / 帆宣系統科技蔡鈞鴻特助主持。

「TSIA 2025Q3 IC 產業動態觀察與展望」由工研院產科國際所鍾淑婷產業分析師解讀全球總體經濟景氣現況，鍾分析師指出，美、中、歐等主要國家地區對製造業的復甦仍存在分歧的看法，但全球半導體市場則維持高成長表現，市場規模將繼續創下新高。鍾分析師也針對「AI 半導體市場與資料中心處理器發展趨勢」分享他的看法，他認為生成式 AI 浪潮引爆了對訓練與推論在算力和記憶體的雙重巨大需求，AI 半導體市場將是未來五年半導體市場擴張的核心力量。因應 AI 浪潮的應用，人形機器人成為近期受矚目的熱門議題。本次專題特別邀請到工業機器人製造大廠上銀科技的吳文加處長來談「從工業機器人到人型機器人的進化之路」。吳處長以幽默風趣的方式，分享他當初進入上銀科技及選擇工業機器人領域的心路歷程作為開場。隨後，他深入剖析工業機器人與智慧製造的結合、AI 賦能人型機器人的應用，以及自主化機器人的發展軌跡這三個面向，最後，他也針對未來機器人技術與產業的發展趨勢提出了看法。活動現場反應熱絡，與會的各界先進透過吳處長的分享，得以觀察 AI 產業與機器人技術在不同維度上的多元發展與潛力。

TSIA 市場資訊委員會正積極規劃 2026 年台灣半導體產業市場趨勢與熱門專題研討會，歡迎業界人員密切注意本協會網站 www.tsia.org.tw 所公佈之活動訊息。TSIA 秘書處聯絡人：陳昱綺資深經理，電話：03-591-7124，Email：doris@tsia.org.tw。

2026 IC DESIGN 聯誼會籌辦及贊助方案

2018 12 月 12 日 IC 設計之友歲末聯誼晚宴 | 經濟部 5G 辦公室主講

2019 5 月 28 日 IC 設計之友夏季聯誼晚宴 | Cadence 台灣贊助

2020 1 月 3 日 IC 設計之友正月聯誼晚宴 | 瑞士銀行贊助

2022 12 月 21 日 IC 設計聯誼會 | 台灣新思科技贊助

2024 3 月 13 日 IC 設計聯誼會 | Cadence 台灣贊助

尋求年度場次聯誼活動贊助廠商，請提供公司 Logo，活動贊助廠商將有專題演講機會、蒞會致詞、宴會免費名額等，專題以業界有興趣之主題為主，可偏軟性題目。
方式：講座、品酒、Golf、Music、Art Exhibition...

贊助級次	單位 (新台幣)	權 益			
獨家	10 萬元	蒞會致詞	專題	宴會免費名額 5 名 (可邀請客戶)	文宣放置贊助商



歡迎有興趣或有其他贊助方案之廠商與 TSIA 聯繫

Doris Chen | Senior Manager

Tel：03-591-7124 | E-mail：doris@tsia.org.tw

TSIA 財務委員會研討會 活動系列報導

■ TSIA / 顏嘉霽 經理

■ 2025Q3- 多變政策下之半導體產業面對國際貿易制裁稅務因應暨永續創新智財管理研討會

面對全球供應鏈重組與美國對等關稅措施，加上 ESG 意識日益攀升，企業如何掌握地緣政治及國際貿易制裁、創造永續創新競爭力，已是半導體產業的關鍵課題。台灣半導體產業協會 (TSIA) 財務委員會與勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte)，於 2025 年 9 月 22 日假新竹國立陽明交通大學電子資訊研究大樓舉辦專題研討會，主題為「多變政策下之半導體產業面對國際貿易制裁稅務因應暨永續創新智財管理」。本研討會由勤業眾信聯合會計師事務所多位領域專家主講，聚焦於：



• 掌握國際脈動 | 解析多變政策下之稅務因應與影響

洪于婷執業會計師深入剖析美國對等關稅及 232 條款政策及關稅對半導體供應鏈之衝擊及影響，快速掌握供應鏈調整策略及稅務分析重點。

• 聚焦永續創新智財管理 | 半導體產業如何提升智財風險韌性落實智財管理

鄭淑芬資深副總講述智財管理新趨勢：探究半導體產業精進智財管理之同時能夠連結 ESG 課題，企業才能落實永續發展，落實智財管理提升智財風險韌性。

• 實務直擊 | 企業於內控制度及作業流程如何因應降低違規風險

張晨威協理探討企業面臨地緣政治及國際貿易制裁之風險及挑戰，分享制裁風險治理最佳實踐，協助企業降低違規風險。

本次活動聚集半導體產業高階主管與法遵、稅務領域專家參與，顯示業界對「稅務、風險與內部控制」等議題高度關注。TSIA 財務委員會持續關注國內外稅務政策演變，並透過與專業機構合作舉辦系列研討活動，協助業者即時掌握全球財稅相關議題趨勢脈動。

■ 2025Q4- 國內重要稅務議題解析暨跨國佈局應注意的外派員工稅務議題

台灣半導體產業協會 (TSIA) 財務委員會與安永聯合會計師事務所 (EY) 攜手合作，於 2025 年 12 月 16 日假新竹國立陽明交通大學電子資訊研究大樓舉辦「國內重要稅務議題解析暨跨國佈局應注意的外派員工稅務議題」專題研討會。

企業若要提升跨國競爭力，精準的稅務策略及規劃不可或缺。一方面，國內稅制瞬息萬變，直接影響企業的經營成本；另一方面，隨著企業布局跨國人力資源，外派員工所涉及的個人所得稅與複雜跨境稅務問題，也日益成為企業財務與人事管理的關鍵挑戰。本次研討會旨在透過對國內重要稅務議題的深入剖析，結合跨國外派稅務成本優化策略，協助企業在確保合規的前提下，實現策略性成長與資源配置最佳化，並提升全球經營決策的精準性與效率。本次研討會涵蓋 2 大重點：



A. 國內重要稅務議題解析

從最新稅法修訂、重大稅務函釋，以及稅務機關實務查核重點，全方位梳理國內稅務環境的最新變化與應對策略，並提供應對策略與實務建議，幫助企業防範潛在的稅務風險。

B. 跨國佈局應注意的外派員工稅務議題

企業在進行跨國佈局時，外派員工的個人所得稅經常成為人事和財務部門的棘手難題。本場研討會將探討外派員工所得申報實務，並結合雙邊租稅協定與國際稅務規範，協助企業降低員工稅負，確保跨國人力資源策略既合規又具成本效益，進而支持企業全球化布局與策略性決策。

TSIA 持續辦理會員公司關心之重要財稅議題，也歡迎 TSIA 會員公司的中高階財稅主管加入 TSIA 財委會給予寶貴意見。若尚未成為 TSIA 會員公司，亦歡迎與 TSIA 秘書處聯絡，了解入會辦法。TSIA 秘書處聯絡人：顏嘉霽經理，電話：03-591-3477，Email: joyce@tsia.org.tw

2025 TSIA 校園巡迴講座系列

臺北市立建國高級中學『智慧經濟爆發成長：AI 與半導體之共生力量』、『分享我的成長：建中 60 級畢業學長』講座報導

■ 鈺創科技 / 盧超群 董事長
■ TSIA / 顏嘉霽 經理



在臺北市立建國高級中學莊智鈞校長積極促成下，建中 60 級傑出校友、鈺創科技等公司創辦人暨董事長盧超群博士，攜手 TSIA、臺灣半導體產學研發聯盟 (TIARA)，於 2025 年 11 月 4 日 (二) 下午共同舉辦『智慧經濟爆發成長：AI 與半導體之共生力量』、『分享我的成長：建中 60 級畢業學長』雙主題專題演講。

盧董事長以自身深耕科技產業歷程，回顧在建中奠定的數理基礎、人格養成與益者三友的啟發，從中提煉人生六大關鍵實戰法則，更以貫穿生命歷程信念「在孤獨中追求卓越，羞辱中真正突破」作為獻給學弟們的人生智慧錦囊，接著引領師生了解博大半導體與 AI 領域知識，並結合對未來發展趨勢的獨到見解，為建中師生帶來一場啟發與知識豐富饗宴。

這段歷程與洞見分享，不僅與建中校訓「勇、誠、樸、勤」及校歌意涵相互輝映，更延續世代學長們傳承與超越的使命，體現「青出於藍而勝於藍」的願景。演講最後，盧董事長勉勵學弟們在 6dMVerse 勇於探索、跨界成長超越，於各自領域綻放並成就真正的「英雄」格局，為國家與世界邁向創新與文明進化的新紀元。



啟動TSIA 產學委員會產學基金募集

TSIA 理監事會於 2013 年 6 月成立產學委員會，宗旨為協助會員善用學術界等資源，以供半導體產業人力資源相關佈局規劃，進而提升半導體產業的研發力與競爭力，促進產業與學界之互動交流，培養學生早期瞭解並參與半導體產業，促成青年才子以半導體產業為其終身事業。

今年計畫持續展開，產學委員會相關計畫執行所需費用需要您的支持，我們邀請所有會員公司共同參與及支持 TSIA 產學委員會產學基金募集，更歡迎個人捐款，共襄盛舉，以利後續工作之推動。

產學委員會目前正在積極進行的工作計劃有：

- 一、規劃執行產業公協會產學訓培育合作網路計畫。
- 二、辦理 CEOs 大專院校校園巡迴演講。
- 三、臺灣半導體產業人才供需調查。
- 四、協辦臺灣半導體產學研發聯盟桂冠計畫 (TIARA)。
- 五、產學基金籌措：目的為支付產學合作運用過程中之必要行政費用，如會議費、專案執行費用、贊助支援 TSIA 半導體獎不足款項及未來陸續新增的產學合作計畫等。

產學基金為專款專用，保管單位為 TSIA 秘書處。本案開收據亦可抵稅，敬邀有志之士共同參與！請填寫並回傳下列回函至 TSIA 秘書處，我們會儘快與您聯絡，謝謝。

本案聯絡人：台灣半導體產業協會 顏嘉霽 經理

Tel : 03-591-3477 E-mail : joyce@tsia.org.tw

公司名稱 / 個人姓名：_____

聯絡人 / 職稱：_____ 電話：_____

E-mail：_____ 傳真：_____

金額：NT\$ _____ (公司/單位 NT\$25,000起，個人無金額限制)

TSIA 委員會活動摘要

■ TSIA / 黃佳淑 資深經理彙整

一、生產製造技術委員會

主委：聯華電子 - 葉志平協理

- 114 年 10 月 21-24 日協辦「國際構裝暨電路板研討會 (IMPACT 2025)」。
- 協助推廣「國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會 (VLSI TSA Symposium 2026)」。

二、IC 設計委員會

主委：工研院電光系統所 - 張世杰所長

- 114 年 8 月 26 日與台灣人工智慧晶片聯盟 (AITA) 及工研院 (ITRI) 共同舉辦「2025 TSIA IC 設計研討會：生成式 AI 晶片與整合設計」。
- 114 年 9 月 5 日舉辦「TSIA 汽車電子主題座談會」。
- 114 年 9 月 24 日召開 TSIA 消費性電子記憶體介面標準工作小組「JEDEC 會後會暨 Workshop」。
- 114 年 12 月 31 日召開 TSIA 消費性電子記憶體介面標準工作小組「JEDEC 會後會暨 Workshop」。
- IP TF 工作小組支援 WSC / GAMS / JSTC 相關 IP 會議。

三、市場資訊委員會

主委：華邦電子 - 洪文章副總經理

- 114 年 8 月 13 日發佈 2025 Q2 IC 產業動態調查報告中 / 英文新聞稿。
- 114 年 8 月 15 日舉辦「TSIA IC 產業市場趨勢暨專題研討會」。
- 114 年 11 月 12 日發佈 2025 Q3 IC 產業動態調查報告中 / 英文新聞稿。
- 114 年 11 月 14 日舉辦「TSIA IC 產業市場趨勢暨專題研討會」。
- 積極參與國際組職 WSTS。

四、財務委員會

主委：力積電 - 邱垂源資深處長

- 114 年 9 月 22 日與勤業眾信聯合會計師事務所 (Deloitte) 合辦「多變政策下之半導體產業面對國際貿易制裁稅務因應暨永續創新智財管理」研討會。
- 114 年 12 月 16 日與安永聯合會計師事務所 (EY) 合辦「國內重要稅務議題解析暨跨國佈局應注意的外派員工稅務議題」研討會。

五、環保安全衛生委員會

主委：台積電 - 房漢文處長

- 114 年 8 月 22 日舉行「2025 高科技產業 ESH 研討會」並發表「高科技產業自主節能減碳共同宣言」。
- 114 年 9 月 12 日出席「環境部化學署 GBL 及 PFAS 等後續管理事宜研商會議」。
- 114 年 9 月 22 日出席由臺灣碳權交易所召開之「先期專案減量額度用於抵減碳費之協議交易手續費說明會」。
- 114 年 9 月 23 日出席由經濟部產業發展署召開之「製造業因應氣候變遷輔導計畫」傳統產業關鍵業者諮詢會議 - 行業別 2030 年減碳路徑修正方法研商會議。
- 114 年 10 月 15 日召開委員會線上會議，討論 CNS 半導體氟氣體國家標準草案、抵換專案法規外加性因應、WSC GAMS 會議、PFAS 環境流佈採樣與檢測及下年度工作預算。

- 114 年 10 月 17 日出席由環境部召開之「放流水污染物削減管理計畫審核作業要點」研商公聽會。
- 114 年 10 月 23 日出席台灣綠色生產力基金會召開之「工業製程與產品使用部門」專家諮詢會議－電子業含氟製程使用率及削減率揭露可行性研商會議。
- 114 年 11 月 3 日出席環境部氣候變遷署召開之「半導體業及液晶顯示器業產品排放強度調查方法學專家諮詢會」。
- 114 年 11 月 3-7 日出席於韓國釜山舉辦之「WSC ESH Committee，JSTC，GAMS 會議」。
- 114 年 12 月 9 日出席環境部化學物質管理署召開之「PFAS 管制使用座談會」。
- 114 年 12 月 17 日召開 2025 年第三次委員會會議。
- 114 年 12 月 22 日召開「碳費徵收對象申請認定屬高碳洩漏風險者審核原則」草案線上研商會。

六、產學委員會

主委：台積電 - 張孟凡處長

- 114 年 8 月 22 日召開 2025 TSIA 產學委員會交流會 - 非半導體領域人才跨域轉入半導體領域。
- 114 年 11 月 4 日假臺北市立建國高級中學舉辦『智慧經濟爆發成長：AI 與半導體之共生力量』校園專題講座，特別邀請到鈺創科技盧超群董事長暨創辦人擔任演講嘉賓。
- 因應經濟部需要希了解公協會推動產學情形，執行辦理「產學訓培育合作網絡計劃」合作案。
- 持續辦理「TSIA 產學校園大使」巡迴校園演講。
- 協助臺灣半導體產學研發聯盟 (TIARA) 推動事務。

七、能源委員會

主委：台積電 - 秦永沛執行副總經理暨共同營運長

- 114 年 7 月 29 日召開 2025 年第一次委員會會議。
- 114 年 9 月 30 日召開 2025 年第一次工作小組會議暨減碳暨低碳生產工作會議。
- 114 年 12 月 10 日出席於台電大樓召開之「第十四次 TSIA 電力供需溝通平台會議」。

八、半導體獎遴選委員會

主委：國立陽明交通大學 - 孫元成校聘副校長

- 執行 2026 TSIA 半導體獎相關申請作業及書面審查。

九、產業政策委員會

主委：聯發科技 - 顧大為共同營運長暨財務長

- 不定期就政府政策召開會議討論，並提交產業立場及建議。

十、JSTC 委員會

主委：台積電 - 張宇恩處長

- 參與 WSC / JSTC / GAMS 相關會議。
- 定期召開 JSTC Post Meeting。

十一、設備委員會

主委：漢民科技 - 林士青副總經理

- 114 年 12 月 2 日召開 2025 年第三次委員會會議。

新會員介紹

■ 編輯部

致茂電子股份有限公司

Chroma ATE Inc.



公司概况：

致茂電子成立於 1984 年，以自有品牌“Chroma”行銷全球，是新興科技產業幕後推手，世界一級客戶信賴的夥伴，以精密量測及自動化全方位解決方案引領新興科技實現創新，主要市場應用包括 AI、半導體 / IC、儲能、電動車、綠能電池、LED、太陽能、光子學、平面顯示器、視頻與色彩、電力電子、被動元件、電氣安規、熱電溫控、自動光學檢測、智慧製造系統、潔淨科技、與智慧工廠領域。每年投入大量研發資源確保其領先關鍵技術及高度整合能力於光學、機械、電子、溫控及軟體，以維持公司的競爭優勢及成長，達到永續經營的目標。致茂營運據點遍佈歐、美、日、韓、中國及東南亞，以創新的技術提供顧客更高的附加價值與服務，滿足客戶需求。

「舞動未來科技 開創美好世界」是公司成長邁進的願景。在致茂，我們深信真相是量測的核心，信賴是與客戶關係的基石。透過與客戶的深度協作，運用先進的解決方案，協助客戶開發創新科技產品，確保產品的性能、品質與成功，贏得信賴。讓科技產業更蓬勃，享受科技帶來的便利，造福社會，並開創更美好的世界。

網址：<https://www.chromaate.com/tw/index>

錡曄電子有限公司

Brilliant Silicon Technology Co., Ltd.



公司概况：

錡曄電子有限公司 (Brilliant Silicon Technology Co., Ltd.) 成立於 2022 年 7 月，是一家專業的無晶圓廠半導體公司。控股公司註冊於開曼群島，並於新加坡、台灣、蘇州（中國）及香港設有子公司。

公司專注於射頻與混合訊號設計、數位設計與 SoC 架構、人工智慧演算法與軟體開發、聲學系統以及無線通訊架構等核心技術領域。

團隊由 30 多名專業人員組成，已成功完成超過 180 個設計專案，並憑藉豐富的量產經驗，能提供從概念到量產的完整解決方案。

在瞬息萬變的半導體產業中，錡曄電子致力於成為客戶最值得信賴的技術合作夥伴，透過持續創新與卓越執行，為客戶創造最大價值，並滿足生活中每一個智慧需求。

網址：<https://bsisemi.com/>

TSIA 入會申請資格及辦法



歡迎申請加入 TSIA 台灣半導體產業協會，請至 TSIA 網站 www.tsia.org.tw 會員專區了解入會辦法，並直接填寫入會申請，或致電 03-591-3477 洽詢，我們將儘速與您聯絡！

會員

團體會員

凡總公司設於中華民國之半導體產業相關機構（研發、設計、製造、構裝、測試、設備、材料及其他與半導體相關廠商），並在台灣設立登記者，填具入會申請書，經理事會審核通過，並繳納會費後，成為會員，並依據所繳常年會費數額推派代表二至三十人行使會員權益。

國際會員

凡總公司設於中華民國境外之半導體產業相關機構（研發、設計、製造、構裝、測試、設備、材料及其他與半導體相關廠商），在台灣設立分公司、辦事處或研發中心，填具入會申請書，經理事會審核通過，並繳納會費後，成為會員。

贊助會員

捐助本會之個人或非半導體相關團體，經本會理事會通過後，得為贊助會員。

榮譽會員

由理事會推薦頒贈。

會費

入會費

會員（榮譽會員除外）於本會時，應一次繳納入會費新台幣 1 萬元整。

常年會費

資本額(新台幣/元)	常年會費/年(新台幣/元)	得派代表人數
二億以下	2萬元	2人
二億(含)~四億	4萬元	3人
四億(含)~十億	6萬元	4人
十億(含)~三十億	12萬元	6人
三十億(含)~一百億	18萬元	8人
一百億(含)~五百億	32萬元	12人
五百億(含)以上	90萬元	30人

級數	定義(根據加入會員時之前一年度排名)	常年會費/年(新台幣/元)
A	全球前二十大半導體公司	60萬元
B	全球前二十大IC公司及各國/地區十大半導體相關公司，非屬於全球前二十大者	15萬元
C	其他	5萬元

贊助會員

每年新台幣 2 萬元整。

2025× SUMMER× SINGAPORE

■ 陳妍蓁

飛機緩緩升空，我望著窗外漸漸遠去的城市天際線，打開手機開始整理這段旅程的照片：一張張熟悉的臉龐、一道道令人垂涎的道地料理、一條條迷過路的街道，彷彿把我拉回那些還未說完的故事……。

七月十七日，凌晨三點的風把我從夢中喚醒，睡眠惺忪的我，拖著沉重的行李，懷著雀躍的心情前往學校集合。班機起飛四小時後，我降落在這片神秘美麗的國度 -- 新加坡。

前兩天，師長帶領我們參訪多個著名景點：在星曜樟宜，傾洩而下的瀑布發出巨大的轟轟聲，伴隨著細微的水滴灑落在臉上，在陽光的照耀下閃耀著微微的光芒；在濱海灣花園，走進高大樹木環繞的綠蔭，腳步不自覺地放慢，彷彿在城市與自然的交界處，找到一片只屬於自己的寧靜。魚尾獅佇立在海灣邊，宛如威風凜凜的守護者，銀白色的瓷磚、藍天白雲以及波光粼粼的潮水，與周圍的海灣景色形成一幅最美麗的風景畫 -- 安靜端莊又不失尊嚴。從牠口中噴出的水柱，不只是海水，還是這座城市文明的象徵，更是連結過去與未來的一涓細流。

接下來幾天，是在華僑中學的生活，新加坡與台灣最大的不同是 " 選課自由與課外活動 "。他們採跑班制，依據不同班群來選課，也沒有班級教室，只有一個長桌放包包。課堂上老師不僅傳授知識，還有小組討論與上台發表時間，強調學以致用，也訓練溝通與表達能力。同學每人一手平板或電腦，學習更數位化也更環保。除了注重讀書時間，也特別看重課外活動，社團幾乎是運動相關的，可見師長很重視健康，學生放學後大多在校運動，與台灣普遍去補習的風氣不同。

學校還安排了文化課程，馬來舞蹈、英式女籃、霓虹燈製作等。其中印象最深刻的是英式女籃：跟台灣的合球很像，我覺得自己打的很上手，練習幾次就熟悉了規則，和隊友一起合作得分。而且同學都好熱情，即使中文不太好，還是會主動聊天，我也會試著用英文回答，每天去學校都能聽到連綿不絕的歡笑聲，我也很快就能融入。在新加坡我感受到了，與台灣不同風格的滿滿人情味。

每天最期待的，是放學後學伴家庭帶我去品嚐在地美食。最有名的肉骨茶 -- 香濃厚重的中藥材以及白胡椒香氣就撲鼻而來，排骨一口咬下去即骨肉分離，肉質恰到好處地柔嫩，油條吸飽湯汁後入口即化，最後再啜一口湯，一種溫暖又滿足的感覺油然而生。還有海南雞飯 -- 雞肉外皮晶瑩剔透又微微彈牙，吸滿雞油香的白飯，配上鮮嫩多汁的雞肉，令人食指大動的忍不住多吃幾口。其中最好吃的是沙爹 -- 一串串排列在炭火上滋滋作響，油脂滴在炭上立刻冒出香煙，香味遠遠就能聞到；表面略微焦脆，肉質卻多汁軟嫩、香而不柴，口味有牛豬雞羊多種選擇，沾著甜甜的醬汁吃更是別有一番滋味。

飛機即將降落，旅程畫下句點，當我闔上手機，望向窗外一片雲海，才明白 -- 離開時以為什麼都沒帶走，但其實，什麼都帶走了。真正裝進手機的不是照片，而是記憶。在飛機上整理著照片，看見了自己的成長，看見了彼此的笑容，也看見了這段旅程留下的每一道光。它們不只是回憶，是我勇敢跨出去的證明，是我遇見世界的起點，也是我學會長大的痕跡。





這趟新加坡的交換學生活動，是個意義非凡的珍貴回憶，與學伴同住，讓我更貼近當地生活：每天一起吃飯、上學、搭地鐵，也聽見了獨特的 Singlish 口音。這些經驗，是旅遊無法取代的珍貴收穫。使我學會了獨立面對挑戰，學會了與來自不同文化的人溝通，學會了在陌生城市找到自己的節奏，更學會了 -- 如何看見世界，也看見自己。

慶幸 16 歲的自己，當時願意交出報名表；慶幸自己鼓起勇氣跨出舒適圈，看見了截然不同的世界風景；慶幸整趟旅途中，幫助過自己的任何人事物。而我，也會繼續用更勇敢的姿態，面對每一段未來的旅程及挑戰！

不確定何時會再訪新加坡，但我知道，那裡有一段……永遠不會忘記的青春回憶。每一張熟悉的臉龐、每一件發生的趣事、每一天的日常，一切在新加坡的點點滴滴，早已深深烙印在心底，靜靜收藏在名為「2025 x Summer x Singapore」的記憶抽屜裡。回到台灣後，我會常常打開它，翻閱那些再熟悉不過的想念。因為我知道 -- 那不是一段旅程，而是一段不想結束的故事……。

在那之後，四個月過去了……我以為，這段故事，會在我們飛機降落在台灣的那一刻畫上句號。直到他們拖著行李，出現在桃園機場出口，笑著朝我揮手，我才明白 -- 原來有些緣分，不會因為距離而結束，而是換了一個地方繼續。

可是這一次，角色悄悄對調了……

在新加坡時，我是被照顧、被帶著到處跑的人；而現在，我成了那個說著「跟我來」、「我幫你」的人。家裡多了雙不熟悉的鞋子，餐桌上多了不同口音交錯的笑聲，日常多了個人隨時跟在我身邊。原本再普通不過的生活節奏，因為他們的到來，變得新鮮起來 -- 騎腳踏車上學、放學繞去吃小吃、在夜市裡介紹美食的名字與味道，那些我從未特別留意的日常風景，竟成了他們眼中最新奇的存在。



起初的我，其實滿是緊張與不安。擔心他們適不適應學校、習不習慣午餐的味道、能不能融入課堂與生活；也擔心行程是否太累、安排是否無聊，更擔心他們在我家，是否真的感到自在。

然而，我的顧慮很快被一一化解。每堂課結束後，學伴總是興奮地分享上課的內容；午餐時，他用相機記錄餐盤裡的風景，也笑著說很好吃；在溫暖的班級氛圍中，同學們主動聊天、嘗試用英文交流，放學後的行程更是一路帶著笑容。看著他自在融入的模樣，我心中的那顆大石，終於悄悄放下。

印象最深刻的一次行程是：有一次跟我家人一起去吃義大利麵，再去信義 101 那邊看聖誕節造景，後來全家又突然開車衝到山上看夜景，回家再一如往常的吃水果大餐。他後來還發限時動態表達自己的開心與感謝，更是問我「下次還能一起跟你家人出去吃飯嗎？」。那天晚上真的很歡樂，吃飯時聊了好多好多，笑聲此起彼落的圍繞在餐廳裡；而每天睡前一起吃水果，不僅是我們倆放鬆閒聊的時刻，還是感情升溫的催化劑，聊生活聊學校聊感情，彼此之間無話不談。

時光匆匆，送別晚會結束了，很快就來到他們準備回國的那一天，才發現，原來我早已不只是「接待家庭」的角色，而是真心把他們當成生活的一部分。道別的那一刻，才真正明白，原來離別會這麼不容易，是因為這段相遇早已走進心裡。一些微小卻真實的片刻 -- 一起趕第一節上課、在返家的路上聊天、回家一起吃水果。那些看似平凡的日子，卻在不知不覺中，成了最捨不得結束的回憶。

這一趟從新加坡開始、在台灣延續的交換學生經驗，即使實際相處只有短暫的十天，也讓我深刻體會到：真正的交流，不是走過多少地方，而是能不能走進彼此的生活。讓我學會照顧、學會理解、學會包容，也學會在不同文化之間，找到共通的情感溫度，讓身邊的每個人都能得到溫暖。

故事或許暫時告一段落，但那些與學伴一起生活的片段，早已成為青春中最柔軟的一頁。原來，交換學生不只是一次出國經驗，還是收穫到不一樣友誼的機會，更是一場讓世界與自己彼此靠近的成長旅程。就如同當初，我與學伴一對一配對到的緣分，我相信那份連結會延伸到未來，無論是否還有再見的那一天，我們都早已成為彼此生命中，獨一無二卻無法抹去的存在。





半導體獎募款

鼓勵青年學子投入半導體前瞻研究，誠摯邀請您共襄盛舉！

為厚植我國半導體產業之長期研發能量，並系統性培育具國際競爭力之高階研究人才，台灣半導體產業協會 (TSIA) 自 2013 年起設立「TSIA 博士研究生半導體獎」及「TSIA 博士後研究員半導體獎」，並於 2014 年首次頒發。為使獎項定義更貼近產業發展與人才培育實務，自 2016 年起正式更名並區分為「TSIA 半導體獎：博士研究生」及「TSIA 半導體獎：具博士學位之新進研究人員」。



本獎項推動迄今已邁入第十三屆，由 TSIA 半導體獎遴選委員會全體委員依公平、公正、嚴謹原則進行評審，成為國內半導體領域具高度公信力與代表性之學術研究獎項。截至目前，累計已表揚具博士學位之新進研究人員 16 位、博士研究生 111 位，總授獎人數逾百位。相關獲獎研究主題涵蓋半導體關鍵技術與前瞻應用領域，對引導青年學子深耕研究、銜接產業需求，發揮實質且長期之示範效益。2026 年 TSIA 半導體獎於 2025 年 10 月中旬正式啟動。獎金來源已於第十五屆第三次理監事聯席會議決議，由全體理監事共同分攤，並由產學基金補足全額，確保獎項推動之穩定性與永續性。為進一步擴大獎項影響力，深化產學合作能量，誠摯邀請會員公司及各界先進踴躍支持與贊助，共同投入資源，持續鼓勵下一世代的深根半導體前瞻研究，推動台灣半導體產業持續領先的關鍵力量。

TSIA 半導體獎款項為專款專用，保管單位為 TSIA 秘書處；捐款可開立收據，並依相關稅法規定享抵稅權益。關於半導體獎得獎人名單及相關新聞訊息，歡迎瀏覽 TSIA 官網：www.tsia.org.tw 或請聯繫秘書處：顏嘉霈經理，電話：03-591-3477，Email：joyce@tsia.org.tw



如果您不是 WSTS 會員
又需要參考 WSTS Data
請看這裡!!!

世界最具公信力的 半導體市場需求面 WSTS 統計資料

為加強服務台灣及周邊部分亞太區非 WSTS 會員，TSIA 與 WSTS 簽署 Distribution License Agreement，代為銷售 WSTS 統計資料給無 End Product & foundry 之非 WSTS 會員。

TSIA 亞太代理銷售地區

台灣、香港、中國大陸、馬來西亞、印尼、菲律賓

WSTS 出版品包括

- (1) **藍皮書 (Blue Book)**，每月出版：將全球半導體出貨地區分為四大區（美國、歐洲、日本、亞太），並各自統計各區的銷售金額及銷售數量（中國大陸資料自 2014 年自亞太區切割出來）
- (2) **綠皮書 (Green Book)**，每月出版：涵蓋自 2000 年以來藍皮書的 467 張表格
- (3) **預測報告 (Forecast Report)**，每半年出版：依當前需求，每半年發布隨後三個年度的預測報告
- (4) **年度報告 (End User Report)**，每年出版：將半導體出貨依五大區、18 項目、分成 6 個最終應用

WSTS Data includes

- **Blue Book**：Worldwide semiconductor shipments covering 205 product categories by revenue and 241 product categories by units, thereof 57 categories split by the regions Americas, Europe, Japan, China and Asia Pacific/All Other.
- **Blue Book History**：Compilation of all Blue Book data since 1991
- **Green Book**：The semiconductor market since 2000 on 467 graphs from the Blue Book
- **End Use**：Semiconductor shipments by 4 regions and 18 product categories into 6 end-use segments
- **Forecast**：Semiconductor industry forecast by quarters of the current and following year and by year for the two subsequent years, similar product and region classification as the Blue Book

If your corporation is located in China (incl. Hong Kong), Malaysia, Indonesia, Philippines and Taiwan and is not a Semiconductor Manufacturer, you may enter a subscription for WSTS Information Services via Taiwan Semiconductor Industry Association (TSIA).

陳昱綺 Doris Chen | Taiwan Semiconductor Industry Association
Tel: 886-3-5917124 | E-mail: doris@tsia.org.tw，或上網查詢 wsts.tsia.org.tw